

华润微电子有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募集资金投资项目：1、“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”；2、“前瞻性技术和产品升级研发项目”。
- 募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：公司拟将“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。

2023 年 4 月 26 日，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）召开了第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结项。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144号文核准，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票292,994,049股（超额配售选择权行使前），募集资金总额375,032.38万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为367,320.13万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年2月19日出具了天职业字[2020]7111号《验资报告》。2020年3月27日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行292,994,049股普通股的基础上额外发行43,949,000股普通股，本次发行的最终发行股数为336,943,049股，增加的募集资金总额为56,254.72万元，连同初始发行规模292,994,049股股票对应的募集资金总额375,032.38万元，本次发行最终募集资金总额为431,287.10万元。扣除发行费用合计为7,712.64万元，募集资金净额为423,574.46万元。保荐机构（主承销商）已于2020年4月1日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计56,254.72万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年4月2日出具了天职业字[2020]18408号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度及要求的規定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 5 月 25 日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司（以下简称“华微控股”）连同保荐机构于 2020 年 6 月 22 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子（重庆）有限公司、华润矽威科技（上海）有限公司连同保荐机构于 2020 年 8 月 25 日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项募投项目为“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”。截至 2023 年 4 月 26 日，除部分待付合同尾款及保证金之外，上述项目已完成建设并投入使用。

（一）本次结项的募投项目募集资金节余情况

截至 2023 年 4 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用及剩余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	待支付合同尾款及保证金金额	利息收入扣除手续费后净额	剩余募集资金金额

8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目	150,000.00	126,813.27	18,658.36		
前瞻性技术和产品升级研发项目	60,000.00	57,672.19	0	16,813.62	43,537.30
产业并购及整合项目	30,000.00	30,000.00	0		
补充营运资金	60,000.00	60,000.00	0		
超募资金：产业并购及整合	123,574.46	123,574.46	0		
合计	423,574.46	398,059.92	18,658.36	16,813.62	43,537.30

注：1、实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，“产业并购及整合项目”、“补充营运资金”、超募资金“产业并购及整合”项目资金已全部使用完毕，详见公司于 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

自公司首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持快速发展，“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”完成后，公司生产能力和研发能力进一步提升。结合公司实际经营情况，为提高募

集资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金和尚未支付合同尾款及保证金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常经营活动。上述永久补充流动资金事项完成后，项目尚未支付的合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、相关审议程序及专项意见

2023年4月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金使用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司或股东利益的情形，因此公司独立董事同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次将首次公开发行股票部分募投项目“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结

项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律规定。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对于公司将首次公开发行股票部分募投项目“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

- (一) 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- (二) 《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日